

## 长电科技 2025 年第三季度业绩说明会记录

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日（星期一）15:30-17:00 通过进门财经电话会议、上证路演中心转播及网络文字互动方式召开了 2025 年第三季度业绩说明会，公司董事/首席执行长（CEO）郑力先生、独立董事郑建彪先生、董事/首席财务长梁征先生、董事会秘书袁燕女士、副总裁吴宏鲲先生等相关人员就公司 2025 年 1-3 季度经营成果及财务具体情况与投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者提出的问题及公司回复情况如下：

**1. 面对国内外同行竞争，长电科技计划如何构建先进封装领域的技术护城河及盈利优势？是依靠 XDFOI 平台与头部客户联合研发，还是通过像并购晟碟这样的产业链整合实现？**

尊敬的投资者，您好。先进封装面向应用发展，要与头部客户协同开发，技术差异化至关重要。在这方面，长电科技已推出面向先进封装的平台，去年也成功举办了首届先进封装开发者大会。当前行业新方案持续涌现需持续关注。我们正将面向未来异质异构方案所需的核心技术元素，与客户进行充分对接和导入。这些核心技术元素可灵活融入异质方案中，搭建出适配不同应用、甚至满足不同客户需求的定制化先进封装解决方案。因此，针对头部客户需求搭建定制化解决方案并开展工艺开发，在先进封装逐步成为集成电路技术发展核心阶段的背景下，尤为重要。这并非仅形成标准化技术、让客户像使用主流封装一样直接套用标准化封装就能实现的，而是需要投入大量资源。

当然，在此过程中，若能进行一定程度的产业链整合，将相关技术开发的优质工艺、优质团队、先进工厂纳入我们的大平台中也十分必要。

晟碟工厂所生产的存储芯片，无论是数据中心端还是端侧，都是支撑芯片高速运转的核心环节。我们也会持续加大产业链整合力度，让整体解决方案更趋完整，始终保持技术与应用的先进性。感谢您的关注与支持！

**2. 目前 AI、汽车电子、存储这些高增长的领域需求都看到了比较明显的增**

长。当我们面临产能紧张的时候，公司的内部决策机制如何平衡后续国内外客户的订单？

尊敬的投资者，您好。长电科技在产能方面的优势，在于公司已构建双循环的产能布局。我们在国内外均拥有充足产能，依托这一布局，可实现“在中国为中国，在海外为海外”的灵活安排，能根据客户具体需求，在区域产能上进行相应匹配。公司也会通过战略规划、年度商业计划等方式提前做好部署，充分预判未来市场需求，力争通过整体产能的均衡布局，满足客户全方位需求。

在产能紧张的情况下，我们的决策会综合考量战略与技术层面的因素、重点大客户的绑定情况等，同时优先保障高附加值订单，以此进行产能分配，助力整体盈利水平稳步提升。我们也期望在业务发展过程中，兼顾盈利与持续健康发展，实现长期业务布局的稳定。感谢您的关注与支持！

**3. 关于四季度的季节性表现，想请教目前部分景气度较高的产业，在四季度是否会延续这一较高景气度？明年公司对下游应用的市场走势是如何判断的？**

尊敬的投资者，您好。整个半导体市场仍在延续上行趋势。从技术应用来看，行业正处于承前启后、辞旧迎新的关键阶段。工业和汽车电子领域虽有此起彼伏的波动，但总体保持持续复苏态势。消费类电子，尤其是中国消费类电子的需求在一系列政策推动下，维持平稳发展态势；加之移动终端持续智能化，也进一步拉动了高端产品需求。人工智能生态的持续壮大，带动的不仅是算力芯片，更是整个人工智能生态链各环节的协同发展，整体需求呈现明显增长趋势。

在此过程中，我们仍需做好传统业务的取舍与产品结构的优化，集中力量在主流封装与先进封装领域，对新技术、新产能进行前瞻性布局。从四季度趋势来看，市场将继续保持稳中向上的势头，这一发展方向延伸至 2026 年，大的方向我们认为不会发生变化。

当然，国际与国内市场受关税及各类政策影响，表现会有所不同。对此，我们将坚定产品结构优化的核心方向，牢牢把握先进技术发展趋势，稳步推进 2026 年市场工作的规划与落地。感谢您的关注与支持！

**4. 无论是 2.5D/3D 封装，还是其他更新型的先进封装形式，从中国市场角**

度，未来两三年的市场规模有望达到怎样的水平？从公司层面来看，我们可服务的目标市场规模大概有多大？异构封装等新兴封装技术领域，哪些方向在当前市场中更具发展机会？

尊敬的投资者，您好。先进封装所服务的、以高性能计算为核心的市场，在中国仍方兴未艾。从集成电路本身的需求来看，过去国内主要依赖进口芯片；随着中国以数据中心为核心的智算市场持续发展，越来越多企业开始开发面向本土的定制化方案。因此，对中国集成电路市场而言，面向本土的定制化方案需求才刚刚起步。同时，得益于对国外先进经验的借鉴，当前不仅是算力芯片的迭代升级，其带动的生态，包括存力、电力等对技术的要求也在提升。过去只需直接采用现成方案，如今需自主开发方案。由此，定制化需求不断细化和提高，将直接催生未来几年国内市场对先进封装及整个产业链的强劲需求。

此外，随着国内基础设施持续强化，端侧市场的 AI 落地趋势也会加速。整体来看，这一领域新技术层出不穷，技术迭代速度极快，主流封装厂的工艺与技术优势被明显释放。这一优势不再仅围绕晶圆本身，还延伸至晶圆相关的各类材料，比如 TGV 所需的玻璃、面板型封装的相关材料，以及光电集成堆叠等异构方案，共同推动技术加速迭代。因此，封装企业与晶圆厂、设计公司及整个供应链的生态协同变得愈发重要。以上就是未来两三年，尤其是中国市场在这一领域将呈现的发展态势。感谢您的关注与支持！

**5. 近两年公司在汽车领域的增速较快。能否展望 2026 年该业务的增速情况？明年哪些产品的增量会比较明显？**

尊敬的投资者，您好。随着汽车新能源化与智能化推进，中国市场已成为主战场。传统汽车每辆搭载三五百个芯片，而新一代新能源智能汽车的芯片搭载量已达到每辆三千个，这一领域的规模实现了质的飞跃。同时，新能源智能汽车的电子架构也发生了重大变革，相关应用与产品领域的发展趋势正逐步显现，整个汽车电子产业正处于新技术持续落地的标志性发展阶段。

对长电科技而言，我们凭借与国际大客户及国内主流车企的紧密合作，以汽车电子核心产品为驱动，带动了各类周边汽车电子芯片的成品制造业务发展。值得关注的是，一方面，先进封装技术及更高规格晶圆的芯片正快速进入汽车

电子领域，推动先进封装在该领域的落地规模持续扩大，这与前几年的发展态势存在明显差异；另一方面，面向汽车电子的功率器件、电源管理芯片呈现全面发展态势，在汽车电子架构的各主要环节，都涌现出了新的技术需求与应用场景。因此，明年我们将看到更多相关新产品在工厂落地量产。

尤其在国内，我们位于上海临港的汽车电子工厂，依托当地完善的汽车电子产业链，在核心客户的推动与产业链日趋成熟的背景下，将逐步发力。上述提及的重点领域，都会有新产品供应国内及海外客户，精准匹配“在中国，为中国”的市场需求。综上，我们对汽车电子业务充满信心，将不断提升汽车电子业务收入占比。感谢您的关注与支持！

**6. 想请您展开分享一下晟碟的经营现状及对存储行业不仅是四季度，还包括明年的整体看法，该行业发展可能给公司带来的业绩弹性？**

尊敬的投资者，您好。整个晟碟工厂的经营状态，正健康良性地发展。并购80%股权后，我们与外方股东共同持续加大对工厂的投入，聚焦新产品的技术更新与产能扩张。

大家都了解，存储产品市场存在一定波动性，具有典型的周期性特征。但叠加当前人工智能在数据中心与端侧的新增需求后，整个存储类产品目前呈现需求大于供给的状态，且这一格局预计在未来一段时间内仍将延续。存储产品本身的结构，包括模组结构也在持续变化：过去仅聚焦存储容量提升与生产制程升级，如今新的产品组合不断涌现，还催生了新的业务模式。因此，后续我们将依托晟碟以及长电科技多工厂布局的存储类产品业务，进一步提升企业级SSD的市场份额，尤其聚焦高密度存储类产品的发展。目前这一规划已在各工厂间形成协同赋能，相信能为业界对存储产品，特别是先进高密度存储产品的需求提供有力贡献。感谢您的关注与支持！

**7. 近期电子产业链上游陆续出现通胀相关因素，从封装环节来看，上游黄金等金属价格波动明显。想向管理层请教公司向客户的涨价传导情况，这一涨价情况对公司毛利率的后续展望是否会产生短期影响？**

尊敬的投资者，您好。今年以来，大宗商品及贵金属价格急剧上涨，给公

司成本带来较大压力。公司已启动与客户的沟通，从下半年起逐步落地金价联动机制，这是国际通行做法，客户接受度较高。此外，长电科技并未因产能紧张而主动向客户提价。我们更看重长期合作共赢，重视与客户共同把握行业复苏机遇。

从毛利率表现来看，尽管金价联动机制在一定程度上缓解了原材料涨价带来的压力，但传导存在一定滞后性，公司毛利仍有一定承压。不过，受益于整体业务向好的态势，三季度公司毛利率同比明显改善，提升 2 个百分点，环比持平。

展望未来，国内工厂的高产能利用率状态预计将持续一段时间，海外工厂在下半年同步进入旺季。我们预计国内外工厂的毛利水平后续将持续改善，公司整体毛利率有望实现稳步回升。公司也会通过强化各项管理、提升管理效率进一步夯实这一态势。短期来看，部分投入期的费用会对毛利率指标产生一定压力；但从中长期来看，随着公司高附加值业务转型升级落地，毛利率及盈利能力有望逐步回升。感谢您的关注与支持！

#### 8. 当前半导体周期仍呈现温和且持续上升的态势，在这一态势下，公司产能利用率的改善幅度、后续改善强度及持续性如何？后续自身的产能扩建规划？

尊敬的投资者，您好。第三季度公司整体产能利用率持续回升，已提升至 8 成左右。目前国内产能处于较为饱和状态，这一方面得益于今年引线类等主流封装产能利用率的整体提升，另一方面也源于国内工厂主流封装先进化进程推进顺利，两方面因素共同带动了国内产能利用率及公司盈利状况的改善。从国内外整体情况来看，先进封装产能需求始终处于较高水平，例如晶圆级封装领域当前呈现供不应求的市场格局。因此，未来我们将加大先进封装，尤其是晶圆级封装的扩产力度，以满足客户需求。去年建成的江阴高密度先进封装产线已实现量产落地，目前正处于快速爬坡阶段。

关于下一步扩产规划，公司将基于对市场的研判，包括人工智能需求带动的相关需求快速增长的情况下，重点聚焦高端产能布局。产能结构规划将围绕以下几方面展开：一是应用领域倾斜，结合未来市场预判，向汽车电子、运算存储、高密度电源等领域适度侧重；二是深化客户合作，始终重视客户关系，

持续强化与头部高端客户的绑定；三是加大研发投入，聚焦先进封装技术及前沿领域的突破，推动技术发展与应用需求深度契合。总体来看，结合当前先进封装的旺盛需求趋势，公司将持续加大相关投资力度。感谢您的关注与支持！

**9. 关于下游需求**当前半导体市场整体呈现稳中向好的趋势。但海外市场仍存在一些不确定性因素，比如关税政策、技术限制等相关影响。在此背景下，想请公司领导谈一谈对 2026 年国内及海外客户的需求展望？

尊敬的投资者，您好。从国内外两个市场来看，受当前国际形势新变化影响，确实呈现出不同的发展态势，这与前些年相比存在明显差异。

国内市场方面，面向中国本土需求的芯片需求正持续增长。无论是海外客户“在中国，为中国”的需求趋势，还是中国本土集成电路企业的需求，都展现出强劲的发展势头，这一趋势十分明显，也带动了中国集成电路产业的进一步发展。

海外市场方面，受关税等因素影响，确实存在一定波动。客户也在根据各地条件变化，调整不同地区工厂的产能分配及物流安排，这不仅对客户自身，也给生产工厂带来了相应的调整压力。

但从大趋势来看，海外市场在人工智能的驱动下，正带动整个生态链持续向前发展。对我们而言，核心是在各类因素交织的背景下，坚持优化产品结构。借着产业市场变化的契机，加快推进与核心客户合作的、具有发展潜力的未来产品落地。与此同时，在当前市场环境下，也是调整和取舍产品结构的良好时机，对于同质化强、可有可无、易在海外市场陷入内卷的产品，逐步收缩布局。这样才能在行业逐步沉淀、形成稳固发展格局时，做好充分准备。以上就是我们对国内外市场需求背后逻辑的相关思考。感谢您的关注与支持！

**10. 关于 2.5D/3D 先进封装业务的相关情况，公司是否方便介绍明年及后年该业务的产能建设规划，以及这一业务对公司收入贡献的相关展望？**

尊敬的投资者，您好。从大方向来看，2.5D/3D 先进封装无疑是整个封测产业未来的核心。无论是明年还是后年，该业务对公司收入的贡献都将逐步显现。从中期目标来看，公司面向运算类电子相关的收入占比不断提升。感谢您的关注与支持！

**11. 近期通讯客户的终端销售表现颇为亮眼，想了解这一情况对公司业绩会产生怎样的影响？公司针对北美大客户下一代产品的布局情况；二是韩国工厂未来的收入增长预期？**

尊敬的投资者，您好。下半年通信行业进入旺季，从长远来看，该领域仍有显著的发展空间。如今的通信已不局限于传统通信范畴，而是朝着智能化通信、AI 端侧应用的方向演进。在终端出货保持良好趋势的背景下，我们需重点关注大客户未来的技术发展路径。其技术布局必然突破单纯的通信领域，目前 5G 发展已逐步平稳，智能化将成为核心发展方向。

对长电科技而言，这一点尤为重要。如果我们仅推出同质化产品，单纯跟随通信终端的发展节奏，在今明两年这个关键调整期，将难以有所表现。我们不能局限于跟进已逐步平淡的传统通信产品，而应紧扣智能化发展的明确趋势，加快产品结构优化的相关举措。

正如之前所提到的，对于那些存在内卷趋势的同质化产品，我们需要主动取舍；而对于未来技术，尤其是先进封装时代中，能够让我们作为头部封装厂充分发挥优势的产品与技术，我们会牢牢把握，加大投资力度，加快跟进这类产品的发展进程。感谢您的关注与支持！

**12. 财报显示公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达 365.61%。公司将采取什么措施来优化应收账款管理，降低潜在风险？**

尊敬的投资者，您好。截至今年第三季度末，公司应收账款余额和去年年底金额基本持平，公司货款回收正常，未有大额逾期发生。公司已建立了较为完善的客户信用分级管理制度，定期回顾，动态调整信用管控策略，保障应收账款及时回收。感谢您的关注与支持！

**13. 公司在运算电子、汽车电子、工业及医疗电子业务收入同比有显著增长。能否分享下针对这些高增长领域，后续在产能扩充和技术升级方面有哪些具体规划？**

尊敬的投资者，您好。结合对市场需求的系统性研判，为应对人工智能领域需求增长及主流半导体复苏带来的高端产能紧张态势，公司正持续推进前瞻

性产能扩充。资本开支及投资资源将集中布局新一代产品技术，中期将围绕汽车电子、运算、存储及功率能源领域，聚焦先进封装技术及前沿领域的突破创新，持续加大研发投入，深化横向品类拓展，进一步构筑公司的产能竞争优势。感谢您的关注与支持！

**14. 公司第三季度研发费用同比增长 24.7%，在 CPO、玻璃基板等先进技术领域取得突破。请问这些技术突破预计何时能大规模应用并转化为实际营收增长？**

尊敬的投资者，您好。公司将结合市场发展及客户需求情况做好准备。感谢您的关注与支持！

**15. 请问内存相关的营收是计入运算电子应用类别吗？**

尊敬的投资者，您好。公司运算类业务主要包括存储、高性能计算等相关应用。感谢您的关注与支持！

**16. 请问今年(85 亿元?) 跟明年的资本开支计划？**

尊敬的投资者，您好。公司今年资本开支计划为 85 亿元，明年资本开支计划将在公司制定后向大家进行披露。感谢您的关注与支持！

**17. 请问，机构投资者去公司调研多？**

尊敬的投资者，您好。有关公司投资者调研的相关情况，您可登录上证 e 互动平台查阅公司发布的投资者关系活动记录表。感谢您的关注与支持！